【特徴】 E T液に食われた形跡は全く見られず、導体部が圧痕状に凹んでいる状態の欠け

【特征】完全不见被 ET 液腐蚀的痕迹,但导线有凹陷痕迹的缺口。

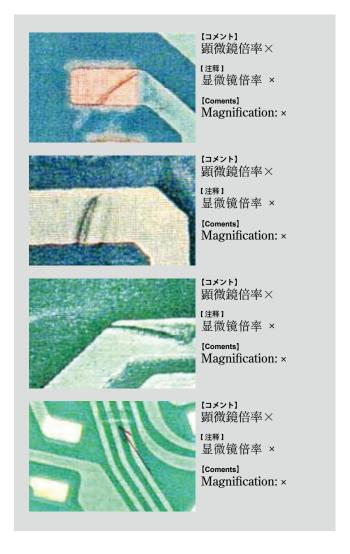
[Characteristics] A conductor is depressed like a dent and nicked. No evidence of etching of conductor is observed.

【原因・判断ポイント・発生工程】回路形成後の基板の重ね作業や、打ち抜きプレス加工時に硬い異物を挟み込んで出来たもの(回路形成後のマテハン、プレス外形加工工程)

【原因、判断要点、发生工序】图形转移后,板件在 堆垛作业或者冲切时,夹杂了硬质杂物而发生的(板 件的搬运、冲切工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

A hard foreign object remains between boards during stacking them after forming conductor pattern or board punching (Material handling after board fabrication and punching process)



1-2-1-13 内層欠け/内层的缺口 / Nick of Inner layer conductor

【特徴】内層回路が欠けている状態の欠陥

【特征】内层线路有缺口的缺陷

[Characteristics] A conductor in an inner layer is nicked.

【原因・判断ポイント・発生工程】内層回路に欠け がある状態のまま積層されて出来たもの

【原因、判断要点、发生工序】内层线路有缺口未经处理就层压而引发的。

[Causes/processes involved/keys to judgment] An inner layer having a nicked conductor is laminated without repair.



■【コメント】 ■顕微鏡倍率×

显微镜倍率×

[Coments] Magnification: ×



【コメント】 顕微鏡倍率×

^{【注释】} 显微镜倍率×

[Coments]
Magnification: ×